



BIOSTONE

Cubiertas con una composición de 94% de cuarzo, esto según la granulidad de la piedra, y el resto un compuesto de resina polímeras con agregados para completar su aspecto, diseño y color.

Producto Qstone, una marca de Sysprotec S.A.

CUBIERTA BIOSTONE	
Espesor	15 - 20 mm
Dureza	Grado 7
Largo	3.04 m 3.20 m
Ancho	1.43 m 1.60 m



Características y uso /

Es la primera cubierta en incorporar una composición de cuarzo, resina y nano partículas de cobre. La cual le brinda a la cubierta biostone unas cualidades únicas de controlar la población de virus y microorganismos en la superficie de la cubierta.

Todo esto mediante un principio activo bactericida que, no solo elimina casi en su totalidad las bacterias, hongos y microbios por inanición, si no que controla la reproducción de los mismos gracias a las propiedades exclusivas del cobre.

Especificaciones técnicas /

Fuerza de compresión	Estándar EN 14617-15
Resistencia Uniaxial a la Compresión	117 Mpa
Fuerza de Flexión	Estándar EN 5133-200
Resistencia a la curvatura - Promedio	55.05 Mpa
Densidad aparente y Absorción de Agua	Estándar EN 14617-1
Densidad Aparente (Kg/m ³)	2403 Kg/m ³
Resistencia a la Abrasión	Estándar ISO 7784.2-97
Porcentaje de Pérdida de masa	0.025%
Resistencia a los Químicos	JC 908-2002
Coeficiencia de expansión térmica lineal	ISO 10545-8
Quemada de Cigarro	No quemada- No marca
Dureza (Mohs)	EN 101:1991 / Grado 7
Dureza	UNE 48 269-1995
Resistencia al impacto	UNE 56817-1974
Resultado	Deterioro Mínimo

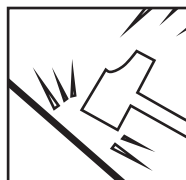
Garantía /

10 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.



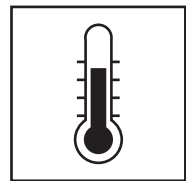
RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y ÁCIDOS



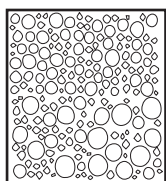
RESISTENCIA AL IMPACTO



RESISTENCIA AL RAYADO

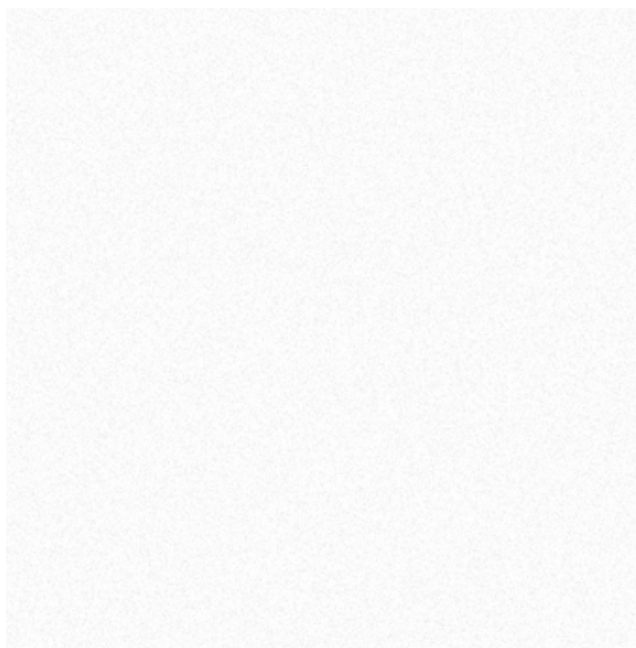


RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS



BAJA POROSIDAD

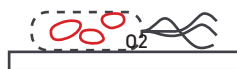
Colores /



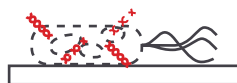
Iones desprendidos de la superficie del cobre por oxidación del , causa daño directo en la célula.



Se rompe la membrana de la celula debido al estres producido por el cobre y otros factores ambientales, perdiendo la membrana y contenido citoplásmico.



Los iones de cobre inducen la oxidación de otros componentes reactivos al oxigeno causando daño celular interno.



Disolución de las cadenas de ADN genómico y plasmídico.